2026年10月9日

各　位

会社名　セイコーエプソン株式会社
代表者名　代表取締役社長　吉田 潤吉
（コード番号：6724　東証プライム市場）
問い合わせ先　IR部
（TEL：0266-52-3131（代表））

会社名　　クラスターテクノロジー株式会社
代表者名　　代表取締役社長　安達 良紀
（コード番号：4240　東証スタンダード市場・名証メイン市場）
問い合わせ先　管理本部
（TEL：06-6726-2711（代表））

セイコーエプソン株式会社（証券コード6724）とクラスターテクノロジー株式会社（証券コード4240）との資本業務提携のお知らせ

セイコーエプソン株式会社（以下 エプソン）とクラスターテクノロジー株式会社（以下 クラスターテクノロジー）は、本日、資本業務提携契約を締結しましたのでお知らせします。本提携の一環として、クラスターテクノロジーが実施する第三者割当増資をエプソンが引き受け、資本提携を行います。

本提携により両社は、それぞれが有する技術や知見を活用し、インクジェットプリントヘッド関連部品をはじめとする高機能部品や次世代材料の開発を進めるとともに、エプソンの需要拡大に対応した安定供給体制を構築します。これにより、インクジェット技術のさらなる高度化と新たな用途への展開を目指します。

記

１．提携の背景

クラスターテクノロジーは、ナノ／マイクロ・テクノロジー関連事業において、精密成形技術とカスタマイズ材料技術を活用し、光学機器やプリンター部品などの精密部品の樹脂化を推進することで、製品の軽量化、高性能化、製造コスト削減に貢献しています。また、マクロ・テクノロジー関連事業では、重電業界向けの樹脂絶縁材料や配電用電気絶縁構造物、樹脂成形碍子などで豊富な実績を有し、長年にわたり産業インフラの安全性・信頼性向上を支えてきました。

一方、エプソンは、長期ビジョン「ENGINEERED FUTURE 2035」のもと、「省・小・精」の技術・思想を基盤に、パートナーとの共創による社会課題の解決と新たな価値創出を目指しています。中でも、インクジェットプリントヘッドを技術の核とするインクジェットソリューションズ

事業を成長領域と位置付け、技術革新や新たな事業機会の創出に向けた出資や共同開発を推進するため、３年間で50億円規模の投資を計画しています。

今回の提携は、こうした取り組みの一環として実施するものであり、両社の強みを組み合わせることで、インクジェットプリントヘッド関連部品や材料技術の開発を進め、インクジェット技術のさらなる高度化と新たな用途への展開を目指します。

２．資本業務提携の内容

クラスターテクノロジーの樹脂複合材料技術および成形加工技術と、エプソンのインクジェット技術や開発力を組み合わせ、インクジェットプリントヘッド関連部品をはじめとする高機能部品や次世代材料の開発を進めます。

また、それぞれが持つ製造技術やノウハウを活用し、生産性・品質の向上および安定供給体制の強化に取り組みます。これにより、お客様への提供価値の向上とインクジェット領域における競争力強化を図ります。

３．資本提携の概要

クラスターテクノロジーは、第三者割当増資を実施し、エプソンと資本提携を行います。エプソンは、本第三者割当増資の引受により３億円を出資し、クラスターテクノロジーとの中長期的な協力関係を強化します。

本件の詳細につきましては、クラスターテクノロジーが2026年10月９日付で適時開示しました「セイコーエプソン株式会社との資本業務提携の締結、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動（見込み）に関するお知らせ」をご参照ください。

https://www.cluster-tech.co.jp/ir_info

４．今後の展開

本資本業務提携を通じて、両社は共同開発や技術交流を進めるとともに、生産・開発の連携を強化し、インクジェット領域における技術力と競争力の向上を図ります。さらに、産業用途をはじめとする成長市場での事業拡大を目指し、お客様への提供価値の向上と新たな事業機会の創出につなげていきます。

以　上